

高云的产品变更通知（GPCN）

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是由于背胶膜供应商产能紧张，引进背胶膜供应商 Henkel，避免断料风险。

描述

增加背胶膜供应商：Henkel。

变更前	1、背胶膜供应商：Lintec 背胶膜型号：LC2850
变更后	1、背胶膜供应商：Lintec 背胶膜型号：LC2850 2、背胶膜供应商：Henkel 背胶膜型号：BSP125

受影响的产品

所有 WLCSP 封装产品。

关键日期

此次变更与 PCN 生效时间同步，自 2021 年 05 月 23 日开始执行，当前产品的 LTB 及 LTS 为 2021 年 05 月 22 日。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

附加文件

无

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2021/02/24	1.0	初始版本。

版权所有©2021 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。